

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2025-035

上海新阳半导体材料股份有限公司

关于投资建设年产 50000 吨集成电路关键工艺材料 及总部、研发中心项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、项目投资概述

根据上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）中长期战略发展规划，满足市场与客户对公司产品的需求，为进一步扩大产品产能，公司拟投资建设年产50000吨集成电路关键工艺材料及总部、研发中心项目（以下简称“项目”），本项目预计投资总额人民币18.5亿元，项目资金全部自筹。

上述事项已经公司2025年4月16日召开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过。上述事项无需提交公司股东大会审议。本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本项目尚需经过政府有关部门批准。

二、项目基本情况

1. 项目实施主体：上海新阳半导体材料股份有限公司

2. 项目名称：年产50000吨集成电路关键工艺材料及总部、研发中心项目

3. 项目投资总额及资金来源：项目总投资185,000万元人民币，其中：年产50000吨集成电路关键工艺材料项目投资147,000万元；总部及研发中心项目38,000万元。固定资产投资183,000万元，流动资金2,000万元。项目资金全部自

筹。

4. 项目建设目标：一是新建年产50000吨集成电路关键工艺材料，包括年产能5000吨超纯芯片清洗液系列产品；年产能6500吨超纯芯片电镀液系列产品；年产能33500吨超纯芯片蚀刻液系列产品；年产能5000吨化学机械抛光液系列产品。二是新建总部及研发中心。

5. 建设内容和规模：年产50000吨集成电路关键工艺材料项目用地面积约为128亩，总建筑面积约17.4万平方米，其中总部、研发中心地上建筑面积约为4.2万平方米，占比约为25%。本项目结合现有厂区现状，整体规划建设，新建建筑物、构筑物和生产辅助设施包括总部、研发中心、设备厂房及停车场等。

6. 建设工期：项目建设周期合计24个月。计划2025年11月开工建设，2027年5月竣工，2027年11月投产，2032年达产。

7. 项目建设地址：本项目选址位于上海市松江区东至徐庄村路，西至上海新阳厂区，南至思贤路，北至面丈河。项目新址位于现有厂区东侧，与现有厂区相邻。新厂区选址，可以与老厂区基础设施共享，结合老厂区，在管理上协同并提升效率，并进一步优化及共享供应链和物流。

三、项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 项目投资的目的

全球半导体产业正处于持续增长的上行周期，中国大陆半导体市场规模增速持续超越全球平均水平。在市场快速扩张的大环境下，公司业务快速增长，订单量持续攀升，现有产能不能满足市场与客户对公司产品的需求，为进一步扩大产品产能，公司拟通过投资新建项目，为技术储备和产品迭代提供基础设施支撑，确保公司长期稳定运营，助力公司可持续高质量发展。

2. 存在的风险和对公司的影响

(1) 项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还须获得政府有关主管部门批准。如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，本项目的推进与实施可能存在延期、变更、中止或终止的风险。

(2) 本次投资项目的建设实施需要一定的周期，预计短期内不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。新建项目可能面临政策变化、市场需求、资源配置、人力资源等不确定因素带来的风险，在新建项目建设运营过程中公司将积极关注政策导向，适时调整经营决策。

(3) 本次投资项目涉及的投资规模、建设周期、效益预测等均为计划数或预估数，同时，未来宏观经济、市场形势等变化也可能对项目经济效益的实现带来不确定性影响。

公司将积极关注该投资项目的后续进展，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行相关审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1. 公司第六届董事会第四次会议决议；
2. 公司第六届监事会第四次会议决议；
3. 第六届独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议；
4. 第六届董事会战略委员会 2025 年第一次会议决议；
5. 上海新阳：年产 50000 吨集成电路关键工艺材料及总部、研发中心项目可行性研究报告。

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日